

Horno Reflow de Sobremesa HR-10LF

Equipos Inteligentes para la Industria 4.0



- Horno reflow de pasta de soldadura sin plomo.
- Listo para el estándar de la industria 4.0
- Transmisión de datos a través de bluetooth
- Aplicación de Android para conectar a una tableta o teléfono inteligente
- 100 programas de usuario diferentes
- Conexión para extracción de humos de soldadura
- Apertura y cierre manual de la puerta.
- Enfriamiento forzado de PCB después de proceso de soldadura

Horno de soldadura reflow con radiación infrarroja y por convección. La convección forzada de aire caliente garantiza un perfil de temperatura uniforme en toda la cámara. Una vez que la puerta se abre, los ventiladores de refrigeración se conectan y enfrian rápidamente la placa de circuito impreso (PCB) y los componentes.

Método de uso:

Conecte el horno a la red eléctrica y el tubo extracción de humos de soldadura a un sistema de filtrado. Despues del primer encendido, el horno está buscando una tableta o teléfono inteligente para enlazarse.

Cuando ambos están conectados en la aplicación de Android, elige la programación del horno. Hay temperaturas y tiempos programables para el precalentamiento, así como temperaturas y tiempos para el punto de soldadura (reflow) y otros datos.

Cuando el horno ya está programado, el usuario puede controlar el proceso con los botones y la pantalla del panel frontal. Hay una señal acústica cuando finaliza el proceso de soldadura. La misma señal aparece en la tableta o teléfono inteligente.

La aplicación de Android muestra el estado del proceso, la hora y la temperatura u otra información. Se está planificando una aplicación para sistemas IOS.



Datos técnicos

Red eléctrica: 230V, 50 Hz

Consumo de energía: 3100 W máximo puntual

Dimensiones (L x W x H): 460 x 370 x 330 mm

Peso: 16 Kg

Dimensiones del Rack: 350 x 220 mm

Max. Dimensiones de PCB: 300 x 200 mm

Max. Altura de los componentes: 55 mm

Max. Ajuste de temperatura : 260°C